

JEITA 環境調和型先端実装技術 成果報告会2015

(旧 鉛フリー化活動 成果報告会)

日時 平成27年7月17日(金) 10:00~17:00 (受付開始 9:30~)
 場所 芝浦工業大学 豊洲キャンパス交流棟(6階) 大講義室
 主催 一般社団法人 電子情報技術産業協会
 企画 JEITA/実装技術標準化専門委員会

P

rogram

司会 山本 克己 氏 テクノオフィス・ヤマモト

10:00~10:05	主催者挨拶 二宮 良次 JEITA 実装技術標準化専門委員会 委員長 (株)東芝
10:05~10:10	来賓挨拶 清野 恵太 氏 経済産業省 商務情報政策局情報通信機器課 電子デバイス係長
10:10~10:30	METIプロジェクト「部品内蔵基板の設計データフォーマットの国際標準化」の取り組み状況 春日 壽夫 氏 基準認証イノベーション技術研究組合 (IS-INOTEK)
10:30~11:00	部品内蔵基板設計データフォーマット標準化の有効性 松澤 浩彦 氏 (株)図研 EDA事業部
11:00~11:30	フロー槽材料の耐エロージョン性評価試験方法のIEC規格化状況 西川 宏 氏 大阪大学 接合科学研究所 スマートプロセス研究センター 准教授
11:30~12:00	「パワーデバイス実装の国際標準化」への取り組み 岡本 正英 氏 JEITA 国プロ準備会副委員長 (株)日立製作所
休 憩 (昼食は各自にてお願い致します)	
13:00~13:30	「0201実装の現状と今後の課題」(1)部品関係 - 世界最小 0201サイズ チップ積層セラミックコンデンサの実用化 - 大森 長門 氏 (株)村田製作所 コンポーネント事業本部
13:30~14:00	「0201実装の現状と今後の課題」(2)はんだ関係 - 0201部品の実装に求められるはんだ材料特性 - 高木 和順 氏 千住金属工業(株) ハンダテクニカルセンター
14:00~14:30	「0201実装の現状と今後の課題」(3)実装機関係 - 実践!! 0201部品の量産実装技術 - 粟生 浩之 氏 富士機械製造(株) ハイテック事業本部
14:30~15:00	EU-ELV指令の動向(高温はんだ、合金等の適用除外規定見直しについて) 加藤 克久 氏 (株)デンソー
休 憩	
15:15~15:40	JEITAでの高温鉛入りはんだの鉛フリー化への取り組みについて 芹沢 弘二 氏 JEITA 高温鉛入りはんだ代替金属材料WG主査 千住金属工業(株)
15:40~16:10	JEITA第2世代低銀系ソルダペースト標準品の市場動向と課題 萩尾 浩一 氏 (株)ニホンゲンマ
16:10~16:30	SAC系はんだ接合寿命予測に関する苅谷モデルの実証実験(その3) 山本 剛 氏 富士通アドバンステクノロジー(株)
16:30~17:00	Sn-Ag-Cu合金における疲労き裂進展挙動の結晶方位依存性 苅谷 義治 氏 芝浦工業大学 工学部 材料工学科 教授

ご挨拶

当協会では、「実装技術標準化専門委員会」を中心に1997年から実装技術の鉛フリー化活動に取り組んで参りました。また、これらの活動成果は、毎年『報告会』を開催し、広く普及を図って参りました。今年も『JEITA 環境調和型先端実装技術 成果報告会』として、この一年間の先進的な実装技術の検討結果および鉛フリー化関連活動成果を、ご報告させていただきます。

今回は、METIプロジェクト「部品内蔵基板の設計データフォーマットの国際標準化」をはじめ、鉛フリー化関連では、フロー槽材料の耐エロージョン性評価試験方法のIEC規格化状況、高温はんだ・合金等の適用除外規定見直しに関するEU-ELV指令の動向、高温はんだの鉛フリー化、JEITAプロジェクト「第2世代リフロー用鉛フリーソルダーペーストの標準化」の結果を受けた第2世代低銀系ソルダーペースト標準品の市場動向等、多岐にわたるテーマについてご報告させていただきます。

他にも、ウェアラブル機器の拡大に伴い、重要性が増してきています0201実装において、部品、はんだ、実装機それぞれの視点からの現状と今後の課題についての報告、「実装技術標準化専門委員会」が独自に取り組んでいる活動として、現在主流になっている錫-銀-銅系鉛フリーはんだの接合寿命予測等についての報告も行わせていただきます。関係各位におかれましてはご多用中とは思いますが、是非ご参加いただき、忌憚のないご意見、活発なご討論を賜りますようお願い申し上げます。

JEITA 実装技術標準化専門委員会 委員長 二宮 良次 [(株)東芝]

参加要領

- 日 時 平成27年7月17日(金) 10:00~17:00 (受付開始9:30~)
- 場 所 芝浦工業大学 豊洲キャンパス交流棟(6階) 大講義室
東京都江東区豊洲3-7-5
http://www.shibaura-it.ac.jp/about/campus_toyosu.html
- 申込方法 参加申込書に必要事項をご記入の上、お申込みください。
登録完了後、登録E-mailアドレスに確認メールをお送り致します。
また、ご登録のご住所宛に「受講票」と「請求書」をお送り致します。
申込書は以下リンクからダウンロードください。
http://home.jeita.or.jp/tss/2015kankyochowa_EntrySheet.xls
(本状下部の申込書に記入の上、FAXでお送り頂いても結構です。)
- 申込期限 平成27年7月10日(金) 必着
- 定 員 100名
(定員になり次第締め切らせて頂きますので、お早めにお申し込みください。)
- 参加費 会員 10,000円(税込)
一般 15,000円(税込)
- 配布資料 成果報告書(当日配布致します)
- お問合せ先 一般社団法人 電子情報技術産業協会
知的基盤部 標準G(岩淵・塩川・澤田)
TEL:03-5218-1059 FAX:03-5218-1078
E-mail:tsc4@jeita.or.jp

会場へのアクセス



最寄駅のご案内：東京メトロ有楽町線「豊洲駅」徒歩7分
JR京葉線「越中島駅」2番出口より徒歩15分

(一社)電子情報技術産業協会／知的基盤部行
FAX:03-5218-1078 E-mail:tsc4@jeita.or.jp

「環境調和型先端実装技術 成果報告会2015」参加申込書

貴社名	会員確認	会員・一般(非会員) (いずれかに○を付けてください。)
-----	------	---------------------------------

※ 会員/一般(非会員)の確認は、JEITA会員一覧< <http://www.jeita.or.jp/cgi-bin/member/list.cgi> > をお願い致します。

参加者氏名	所属役職名
連絡先住所 (〒)	
TEL番号	FAX番号
E-mail	

※ 複数名の参加申込みの場合は、以下にご記入ください。(受講票と請求書は参加者ごとに個別にお送り致します。)

参加者氏名	所属役職名
連絡先住所 (〒)	
TEL番号	FAX番号
E-mail	